



達興材料股份有限公司

股票代碼：5234

法人說明會

2024.08.15



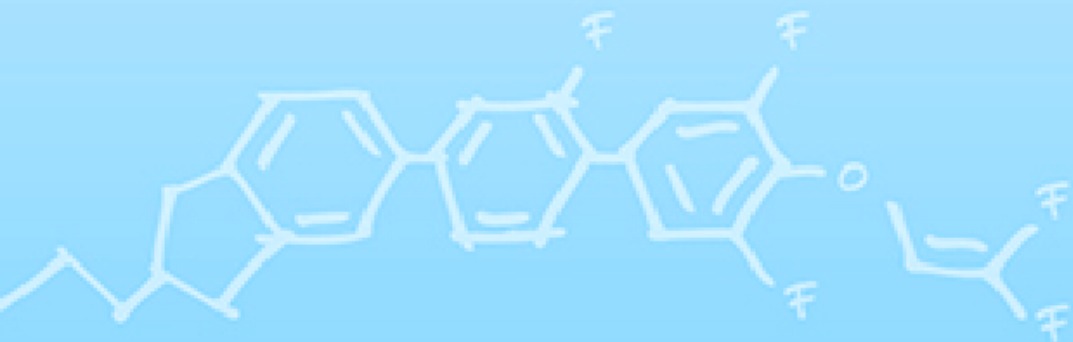
Design House for Chemical Materials

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

簡報大綱

- ◆ 公司簡介
- ◆ 經營成果
- ◆ 未來展望



公司簡介

公司基本資料

創立日期

2006年7月12日
(友達光電及長興材料合資成立)

資本額

新臺幣10.27億

員工人數

截至2024年2月之員工人數為 431 人
研發人員 > 50%

上市日期

2012年7月16日 (股票代號：5234)

合併營收

2023年：42.64億

主要營業項目

顯示器材料
半導體材料
關鍵原材料
其他特用精細化學材料



主要產品

顯示器材料

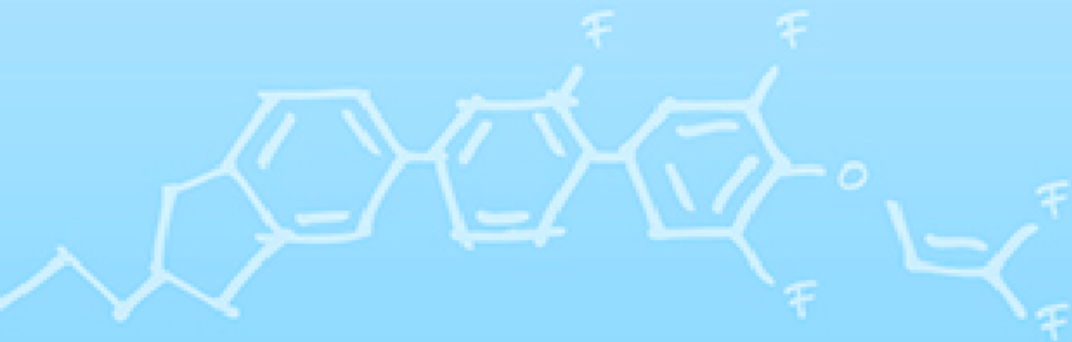
- 用途: 應用於LCD Array, Cell, Color Filter之直接永久材及間接製程材
- 產品: 光阻、配向膜、蝕刻液、光學膠、保護層、濕式化學品

半導體材料

- 用途: 應用於晶圓製程及封裝製程之直接永久材及間接製程材
- 產品: 有機離型層、剝離液、高純度溶劑、蝕刻液、特用保護膠材

關鍵原材料

- 用途: 應用於綠能產業及化學相關應用之上游關鍵原料
- 產品: 特用單體、壓克力高分子、鋰電池矽負極高分子



經營成果

合併綜合損益表-1

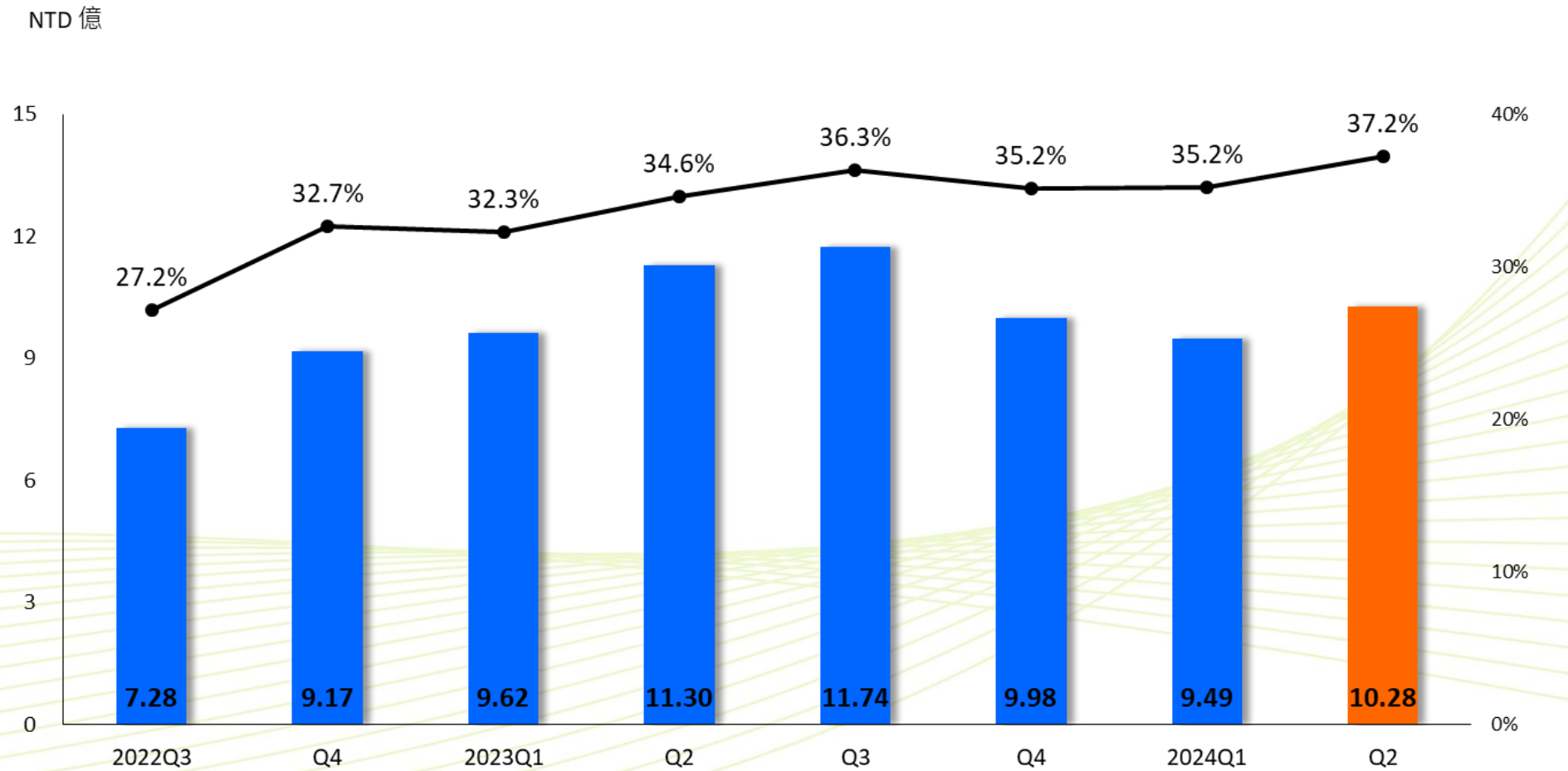
Unit : NTD M

	2024 Q2		2024 Q1		QoQ	2023 Q2		YoY
營業收入	1,028.2	100.0%	948.8	100.0%	8.4%	1,130.3	100.0%	(9.0%)
營業成本	645.3	62.8%	614.6	64.8%	5.0%	739.2	65.4%	(12.7%)
營業毛利	382.9	37.2%	334.1	35.2%	14.6%	391.1	34.6%	(2.1%)
銷售費用	51.6	5.0%	43.7	4.6%	18.2%	47.4	4.2%	9.0%
管理費用	54.8	5.3%	52.7	5.6%	3.9%	51.1	4.5%	7.1%
研發費用	126.3	12.3%	117.4	12.4%	7.6%	120.9	10.7%	4.5%
營業費用	232.7	22.6%	213.9	22.5%	8.8%	219.4	19.4%	6.1%
營業淨利	150.1	14.6%	120.3	12.7%	24.8%	171.6	15.2%	(12.5%)
營業外收(支)	14.0	1.4%	12.9	1.4%	8.8%	4.2	0.4%	230.5%
稅前淨利	164.1	16.0%	133.1	14.0%	23.3%	175.9	15.5%	(6.7%)
所得稅費用	20.4	2.0%	19.1	2.0%	6.6%	25.5	2.3%	(20.1%)
本期淨利	143.7	14.0%	114.0	12.0%	26.1%	150.4	13.3%	(4.4%)
其他綜合損益	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%
綜合損益總額	143.7	14.0%	114.0	12.0%	26.1%	150.4	13.3%	(4.4%)
基本每股盈餘 (NTD)	1.40		1.11			1.46		

合併綜合損益表-2

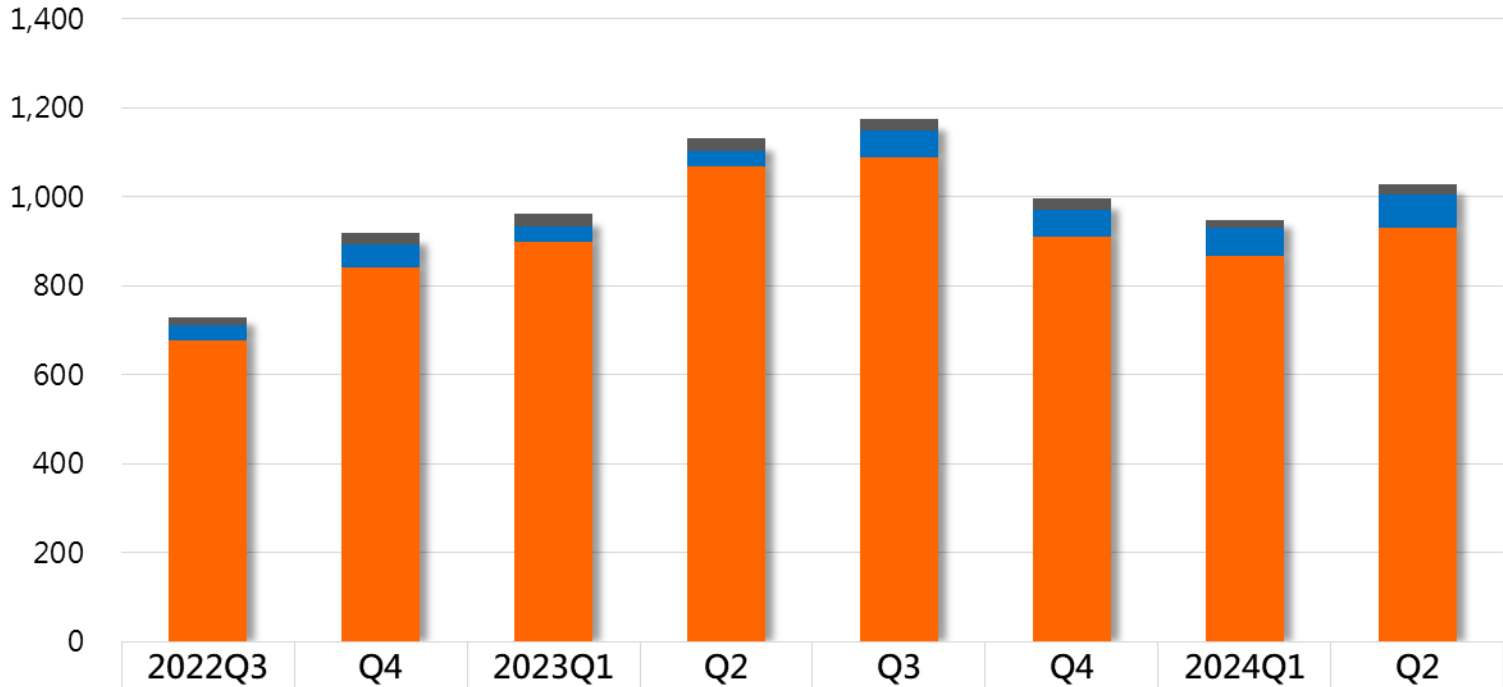
Unit : NTD M	2024 H1		2023 H1		年成長
營業收入	1,977.0	100.0%	2,092.2	100.0%	(5.5%)
營業成本	1,260.0	63.7%	1,390.6	66.5%	(9.4%)
營業毛利	717.0	36.3%	701.6	33.5%	2.2%
銷售費用	95.3	4.8%	90.1	4.3%	5.8%
管理費用	107.5	5.4%	96.2	4.6%	11.7%
研發費用	243.8	12.3%	228.8	10.9%	6.6%
營業費用	446.6	22.6%	415.1	19.8%	7.6%
營業淨利	270.4	13.7%	286.5	13.7%	(5.6%)
營業外收(支)	26.8	1.4%	2.4	0.1%	1014.7%
稅前淨利	297.2	15.0%	288.9	13.8%	2.9%
所得稅費用	39.5	2.0%	40.1	1.9%	(1.5%)
本期淨利	257.7	13.0%	248.8	11.9%	3.6%
其他綜合損益	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
綜合損益總額	257.7	13.0%	248.8	11.9%	3.6%
基本每股盈餘 (NTD)	2.51		2.42		

營收及毛利率趨勢



產業別營收

(NTD M)

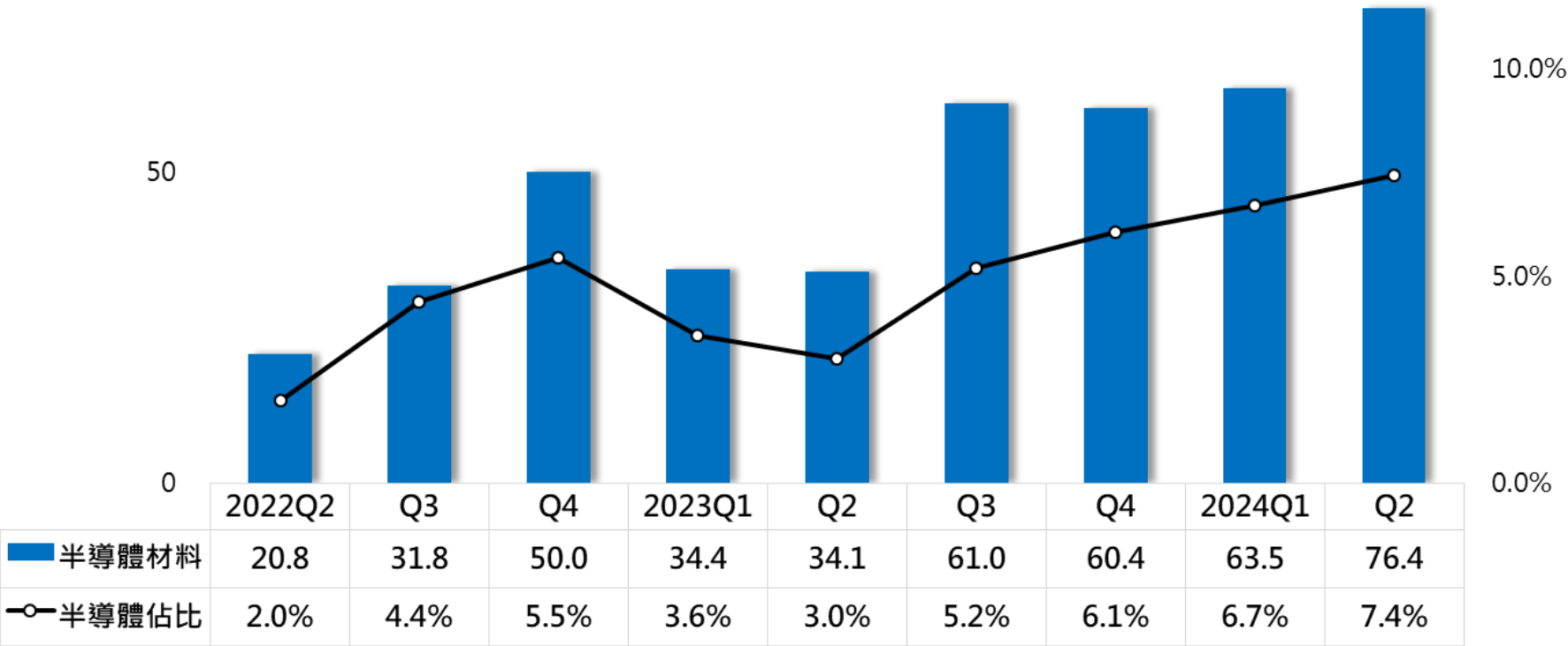


	2022Q3	Q4	2023Q1	Q2	Q3	Q4	2024Q1	Q2
■ 關鍵原材料及其他	17.4	25.8	27.8	26.6	25.2	26.8	19.3	22.6
■ 半導體材料	31.8	50.0	34.4	34.1	61.0	60.4	63.5	76.4
■ 顯示器材料	678.4	841.5	899.7	1,069.6	1,088.1	910.4	866.0	929.2
TOTAL	727.6	917.3	961.9	1,130.3	1,174.3	997.6	948.8	1,028.2
關鍵原材料及其他佔比	2.4%	2.8%	2.9%	2.4%	2.1%	2.7%	2.0%	2.2%
半導體佔比	4.4%	5.5%	3.6%	3.0%	5.2%	6.1%	6.7%	7.4%

半導體營收

(NTD M) 100

15.0%



合併資產負債表摘要



Unit: NTD M

	2024/6/30		2023/6/30		年成長	年成長 %
現金及約當現金	202	4.2%	137	2.9%	65	47.2%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	1,342	28.2%	1,039	21.7%	303	29.2%
應收帳款	1,105	23.2%	1,364	28.5%	(259)	(19.0%)
存貨	360	7.6%	375	7.8%	(14)	(3.9%)
不動產、廠房及設備	1,525	32.0%	1,578	33.0%	(53)	(3.4%)
使用權資產	159	3.3%	168	3.5%	(9)	(5.4%)
資產總計	4,763	100.0%	4,783	100.0%	(20)	(0.4%)
流動負債	1,424	29.9%	1,566	32.7%	(142)	(9.1%)
非流動負債	368	7.7%	358	7.5%	10	2.7%
負債總計	1,791	37.6%	1,924	40.2%	(133)	(6.9%)
權益總計	2,971	62.4%	2,859	59.8%	112	3.9%

重要財務指標

流動比率%	214%	192%
存貨週轉天數	51	48

合併現金流量表摘要



Unit: NTD M

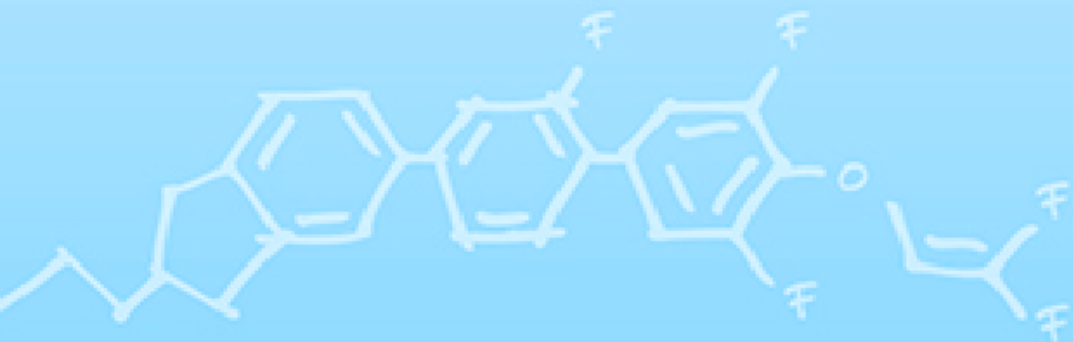
	2024 H1	2023 H1
本期稅前淨利	297	289
折舊及攤銷	136	129
營運資金變動	(50)	(367)
營業活動之淨現金流入(流出)	304	(22)
取得不動產、廠房及設備	(111)	(122)
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	(181)	15
投資活動之淨現金流出	(294)	(109)
舉借短期借款	-	95
償還長期借款	(48)	(34)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(52)	57
本期現金及約當現金增減少	(42)	(74)
期末現金及約當現金餘額	202	137

註：2024/6/30及2023/6/30期末現金及約當現金加計超過三個月以上定存餘額分別為1,543M及1,175M。

股利政策

■ 維持高配息政策。

年度	EPS	現金股利	股票股利	股利發放比率
2023	5.10	4.1	0.0	80%
2022	4.15	3.3	0.0	80%
2021	6.62	5.3	0.0	80%
2020	6.15	5.0	0.0	81%
2019	6.33	5.0	0.0	79%



未來展望

顯示器方面

- ◆ 全球高世代LCD面板第二季平均稼動率維持在高檔 (>80%)，因先前面板拉貨提前，加上上半年中國和歐美市場銷售不理想，品牌廠展開庫存調控，7月面板廠啟動控產保價，稼動率將調至80%附近並延續整個第三季，盼第四季의週期性旺季到來而有所扭轉。

半導體方面

- ◆ 半導體產業經歷超過一年以上庫存調節後，隨AI全力助攻，刺激各項應用興起，下半年台積電先進製程3nm/5nm產能仍吃緊、先進封裝CoWoS供不應求，成熟製程需求回溫加上2025年美國對中國半導體提高關稅 (25%→50%)，預期相關半導體廠商可望受惠。

2024年營運展望

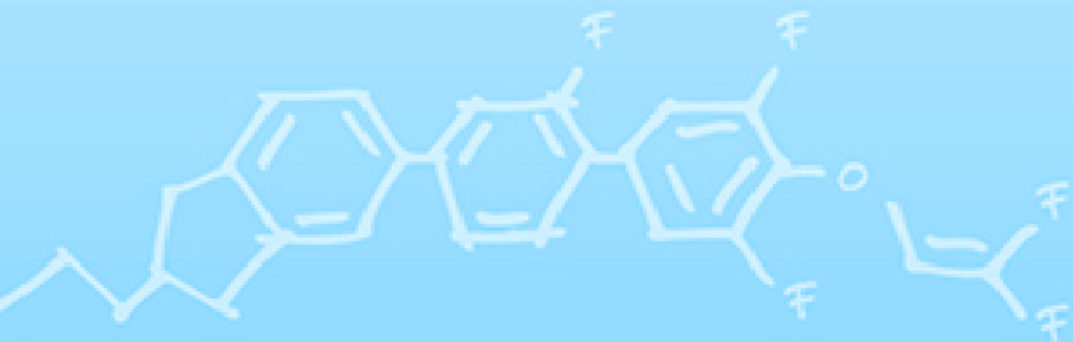
基於當前業務展望，達興公司預期2024年審慎穩健：

◆ 顯示器材料方面

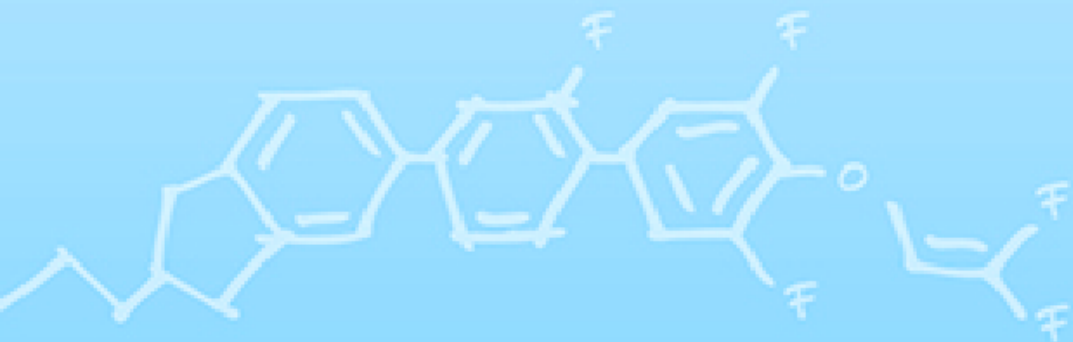
- 加速重點產品液晶配向膜放量導入時程
- 提升品質及價格競爭力，保持優勢及擴大市佔
- 開發更高規格及低溫低碳符合ESG永續潮流新材料

◆ 半導體及關鍵原材料方面

- 推升半導體營收占比，三種經營模式同時並進
(1. 自主研發；2. 與國際材料大廠合作；3. 與國際半導體大廠共同開發)
- 精進新產品開發驗證問題解決應對速度及能力
- 延伸產品觸角至多元應用領域之上下游產業鏈



Q & A



Thank you